

イーヴィグループとパナソニック プラズマダイシング工程におけるレジスト塗布ソリューションを提供

イーヴィグループ(本社:オーストリア、ザンクトフローリアン・アム・イン、社長:エリック・タルナー/以下EVG)とパナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社(本社:大阪府門真市、代表取締役社長:青田広幸/以下PSFS)は、今後成長が期待されるIoT向けセンサー・MEMS・RFID・CMOSイメージセンサーおよび薄型メモリー向けに開発されたプラズマダイシング工法において、両社で連携を図り、その前工程に当たるレジスト塗布工程で新しいソリューションの提供を2019年3月13日より開始します。

プラズマダイシング工法は、センサー・MEMS・RFIDなど小チップにおいて、ウエハー全面の一括高速加工を可能とし、CMOSイメージセンサーでは切削粉が出ないことによる高歩留まり、メモリーではウエハー薄化に対してもダメージフリーで高品質を実現するといった特長があります。

プラズマダイシング工法の前工程においては、ウエハー表面にマスクとなるレジストを数十 μ mの厚膜で塗布し、ダイシング部をレーザーやフォトリソでパターニングします。しかしながら、この工程では、多層の配線構造を持つウエハー表面に5 μ m程度の段差があり、さらに電極部にはバンプを持つウエハーが多いため、プラズマダイシング用レジストを均一な厚膜で塗布できないといった課題がありました。

この課題を解決するため、EVGは塗布装置EVG100シリーズにおいて、独自のOmniSpray®技術によりプラズマダイシング向けにウエハー表面の段差構造に依存しない均一な塗布方法を開発し、従来の技術では困難であったバンプ付きウエハーに均一な厚膜でレジストを塗布することが可能となりました。

さらにPSFSは、大阪府門真市にあるプラズマダイシング実証センターにEVG100シリーズを導入し、レジストをバンプ付きウエハー表面に塗布・パターニングした後、PSFS製プラズマダイサーAPX300ダイサーモジュールで高速・高品質にダイシングするソリューションを開発しました。

EVGとPSFSは、プラズマダイシング実証センターにおける実証を通して、この新しいレジスト塗布ソリューションの提供を開始し、お客様のダイシング品質、生産性向上などへの貢献を目指していきます。

【お問い合わせ先】

イーヴィグループ

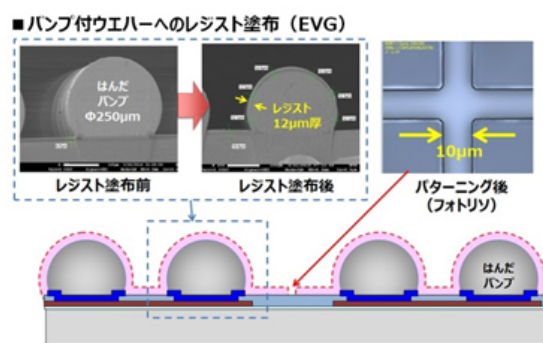
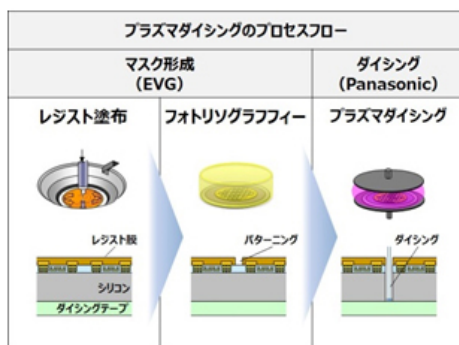
マーケティング&コミュニケーション担当

TEL:+43-7712-5311-0

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

経営企画部

TEL:050-3487-3587



EVG製レジスト塗布装置EVG150



PSFS製APX300ダイサーモジュール

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。